

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

授出購股權 第二份補充公告

茲提述晶門半導體有限公司(「本公司」)於2023年3月24日刊發有關授出購股權的公告及於2023年3月28日刊發有關授出購股權的補充公告(統稱「該等公告」)。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告所用者具有相同涵義。

本公司謹就該等公告的內容提供以下額外資料：

表現目標及退扣機制：

購股權並無附設表現目標或退扣機制。購股權計劃旨在給予合資格參與者機會獲得本公司專有股份和鼓勵共同合作為本公司及其股東利益而提升本公司價值。

董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)認為，並無必要設定表現目標，原因是(i)購股權的價值受股份的未來市價影響，而未來市價乃取決於本集團業務表現，承授人對此將有直接貢獻；及(ii)購股權受該等公告所述歸屬期及若干歸屬條件所規限，以確保承授人將有動力為本公司發展作出貢獻。

此外，考慮到2013年購股權計劃已訂明購股權在不同情境下將會失效及註銷，而此舉已足夠保障本集團利益，故薪酬委員會認為，退扣機制並非必要。

因此，薪酬委員會及董事會相信，即使不設定額外的表現目標及退扣機制，授出購股權可促進承授人與本公司及本公司股東之間的利益一致，激勵承授人為本公司的未來持續競爭力、經營業績及增長而努力，以及加強彼等對長遠服務本公司的承諾，與2013年購股權計劃的宗旨一致。

承董事會命
晶門半導體有限公司
公司秘書
余俊敏

香港，2023年4月3日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。